

F-007

⑥日本国特許庁(J.P.)

①特許出願公開

②公開特許公報(A) 平3-18112

⑤Int.Cl.<sup>1</sup>

H 03 H 7/01  
H 05 K 1/18

識別記号

序内整理番号

Z 7328-5J  
S 6736-5E

④公開 平成3年(1991)1月25日

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全5頁)

③発明の名称 チップ型ノイズフィルタの取付け構造

④特 願 平1-152799

⑤出 願 平1(1989)6月14日

⑥発明者 坂本 幸夫 京都府長岡市天神2丁目26番10号 株式会社村田製作所  
内

⑦発明者 金子 敏己 京都府長岡市天神2丁目26番10号 株式会社村田製作所  
内

⑧発明者 山本 秀俊 京都府長岡市天神2丁目26番10号 株式会社村田製作所  
内

⑨出願人 株式会社村田製作所 京都府長岡市天神2丁目26番10号

⑩代理人 弁理士 森下 武一

### 明細書

#### 1. 発明の名称

チップ型ノイズフィルタの取付け構造

#### 2. 特許請求の範囲

1. 基板裏面上に形成されたグランド導体とその両側に形成された信号導体路との間を電気的に接続しているチップ型ノイズフィルタの取付け構造において、

整列配置された信号導体路がグランド導体の両側に対向して形成されていて、前記グランド導体上にノイズフィルタのグランド電極用接続部分を除いて絶縁層が形成され、この絶縁層の上に前記信号導体路から伸びた導電性接続部が対向して形成され、さらにこの接続部の上にノイズフィルタが整列配置されている構造を成し、前記信号導体路が前記接続部を介してノイズフィルタの両端に設けられた信号電極と電気的に接続されていて、かつノイズフィルタの中央部に設けられたグランド電極が前記グランド導体と前記グランド電極用接続部分で電気的に接続されていることを特徴と

するチップ型ノイズフィルタの取付け構造。

#### 3. 発明の詳細な説明

#### 度量上の利用分野

本発明は、電子回路、特にデジタル回路におけるノイズ防止のためのフィルタ群を基板に取付けける構造に関する。

#### 技術的背景と課題

電子回路、特にデジタル回路のノイズ対策として採用されている方法の一つに信号導体路とグランド導体との間をノイズフィルタ、一般にはバイパスコンデンサを介して接続して高周波成分のノイズをグランド導体に遮がして除去する方法が知られている。バイパスコンデンサとしては、例えば第5図(a)に示すチップ型三端子コンデンサ10がある。三端子コンデンサ10は、両端部に信号電極(A)、(B)及び中央部にグランド電極(C)が形成されている。第5図(b)にチップ型三端子コンデンサ10の等価回路図を示す。

ところで、ノイズフィルタが、コネクタの近傍に配置して使用される場合、コネクタの各ピン毎

に三端子コンデンサ10が1個接続されることが多い。このとき、三端子コンデンサ10は從来第6図(a)に示すように、整列配置され、密接した状態で基板11に取付けられる。即ち、第6図(b)に示すようにグランド導体12a,12b,12c及び信号導体路13a,13bは基板11の上面に形成されていて、信号導体路13a,13bは平行に整列配置され、かつ対向している。信号導体路13bは右側でコネクタ(図示せず)と接続されている。グランド導体12aは三端子コンデンサ10のグランド電極(C)と電気的に接続されるもので、グランド導体12a,12b間に架橋している。グランド導体12cは、アセンブリ工程で信号導体路13a,13bとの間に半田ブリッジを発生させず、しかも三端子コンデンサ10のグランド電極(C)と電気的接続が確実に行なえるだけの構を有している。三端子コンデンサ10は、信号導体路13aと信号電極(A)との間、信号導体路13bと信号電極(B)との間、及びグランド導体12cとグランド電極(C)との間に半田を介して接続されている。

本発明の課題は、高密度に実装されたノイズフィルタ群のフィルタ特性が充分發揮できる取付け構造を提供することにある。

#### 課題を解決するための手段

以上の課題を解決するために、本発明に係るチップ型ノイズフィルタの取付け構造は、整列配置された信号導体路がグランド導体の両面に対向して形成されていて、前記グランド導体上にノイズフィルタのグランド電極用接続部分を除いて絶縁層が形成され、この絶縁層の上に前記信号導体路から伸びた導電性接続路が対向して形成され、さらにこの接続路の上にノイズフィルタが整列配置されている構造を成し、前記信号導体路が前記接続路を介してノイズフィルタの両端に設けられた信号電極と電気的に接続されていて、かつノイズフィルタの中央部に設けられたグランド電極が前記グランド導体と前記グランド電極用接続部分で電気的に接続されていることを特徴とする。

#### 作成用

即ち、グランド導体は、ノイズフィルタの長さ

ところが、以上の取付け構造では、グランド導体12cの幅が三端子コンデンサ10の寸法、特に長さの制約から細くならざるを得ず、このような細長い線形状をした導体は、いわゆるコイルとしての機能を有する。従って、各三端子コンデンサ10のグランド電極(C)間及びグランド電極(C)とグランド導体12a,12b間にそれぞれインダクタンスL1,L3,L4,L5,L1,L6が発生し、これらインダクタンスL1~L6は三端子コンデンサ10のグランド電極(C)に直列に入る。第6図(a)の等価回路を第6図(c)に示す。

このため、三端子コンデンサ10の高周波ノイズ除去作用が阻害されてフィルタ特性が充分發揮されない場合があった。また、インダクタンスL1~L6は電流の変化 $di/dt$ によって $L \cdot di/dt$ のノイズ電圧を生じさせ、しかも、この電流の変化 $di/dt$ はインダクタンスL1~L6を介して全ての三端子コンデンサ10に影響を与えるため、いわゆる共通インピーダンスノイズを発生させるという問題点があつた。

に関係なく独立してその幅を広くできるので、ノイズフィルタのグランド電極に直列に入っているインダクタンスL1の数値は極めて小さいものにでき、高周波ノイズ除去作用を阻害せず、また、ノイズ電圧も小さいものになる。

#### 実施例

以下、本発明に係るチップ型ノイズフィルタの取付け構造の実施例をその取付け方法と共に図面に従って説明する。本実施例では、チップ型ノイズフィルタとして第5図に示すチップ型三端子コンデンサ10を使用し、この三端子コンデンサ10が5個整列配置された場合について説明する。

まず、第1図に示すように、基板1の上面にグランド導体2a,2b,2c及びグランド導体2cの左右に信号導体路3a,3bを形成する。信号導体路3a及び3bは平行に整列配置され、かつ対向して形成されている。図示されていないが、例えば信号導体路3aは左側でIC等の電子回路素子と接続され、信号導体路3bは右側でコネクタと接続されている。グランド導体2cは三端子コンデンサ10のグランド

電極(C)に接続するためにグランド導体2a, 2b間を架橋している。グランド導体2cの幅は従来のものよりかなり広く、通常は三端子コンデンサ10の長さよりも広い幅が採用される。

次に、第2図に示すように、絶縁層4a, 4bをグランド導体2cの上にギャップ5を有して形成する。このギャップ5は三端子コンデンサ10のグランド電極(C)に接続されるために足りる幅である。また、絶縁層4aの左辺はグランド導体2cの左辺より若干はみ出るように形成され、信号導体路3aとグランド導体2cとの間に絶縁不良が発生しないようにしている。同様の理由から、絶縁層4bの右辺は、グランド導体2cの右辺より若干はみ出るように形成されている。絶縁層4a, 4bの材料はエポキシ樹脂等が使用される。

その上に、第3図に示すように、対向する導電性接続路6a, 6bをスクリーン印刷又はスパッタリング等の方法によって形成する。接続路6a, 6bは

一部は信号導体路3a, 3bの上に形成され、一部は絶縁層4a, 4bの上に形成され、三端子コンデンサ10の信号電極(A), (B)と接続される位置まで信号路を延長させる。接続路6a, 6bの幅は、望ましくは三端子コンデンサ10の幅にほぼ等しい幅で形成される。接続路6a, 6bの材料はPd, Ag-Pd, Al等が使用される。

さらに、第4図に示すように、三端子コンデンサ10を並列配置して取付け、接続路6aと信号電極(A)との間、接続路6bと信号電極(B)との間、及び絶縁層4a, 4bのギャップ5に露出しているグランド導体2cとグランド電極(C)との間を半田を介して電気的に接続すると共に三端子コンデンサ10を固定する。

以上の方法により、本発明のチャップ型ノイズフィルタの取付け構造が形成される。即ち、グランド導体2c上に絶縁層4a, 4bがギャップ5を有して形成され、さらにこの絶縁層4a, 4bの上に信号導体路3a, 3bから延長された接続路6a, 6bが対向して形成され、この接続路6a, 6bの上に三端子コン

デンサ10が置かれている構造になっている。本発明の等価回路は第6図(c)に示す等価回路と同じものとなるが、グランド導体2cは広い幅を確保できるのでインダクタンスL1~L6の数値の小さいものが得られ、フィルタの高周波ノイズ除去作用を阻害せず、また、ノイズ電圧も小さいものになる。

なお、本発明に係るチャップ型ノイズフィルタの取付け構造は前記実施例に限るものではなく、その要旨の範囲内で種々に変更することができる。

三端子コンデンサ10のグランド電極(C)とグランド導体2cを接続するためのグランド電極用接続部分は、必ずしもギャップ5である必要はなく、グランド電極(C)の接続に最低限必要な大きさの部分が確保されていればその形状は問わない。また、信号導体路3a, 3bをも絶縁層4a, 4b上に延長形成して接続路の一端あるいは全部としてもよい。発明の効果

本発明によれば、グランド導体の幅をノイズフィルタの大きさに関係なく独立して広くできるので、グランド導体が有するインダクタンスは極めて小

さいものとなる。この幅の広いグランド導体にノイズフィルタのグランド電極を、電気的に接続できるので、ノイズフィルタのグランド電極に直列に入っているインダクタンスLの数値も極めて小さいものになり、ノイズフィルタの高周波ノイズ除去作用を阻害しない。

また、電流の変化 $di/dt$ によって生ずるノイズ電圧 $L \cdot di/dt$ もインダクタンスLの値が極めて小さいので実用上無視でき、共通インピーダンスノイズの問題も解決する。

この結果、ノイズフィルタの本来のフィルタ特性が充分発揮できるチャップ型ノイズフィルタの取付け構造が提供される。

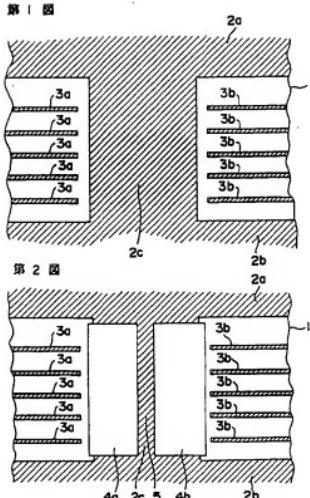
#### 4. 四面の簡単な説明

第1図、第2図、第3図、第4図は本発明の一実施例であるチャップ型ノイズフィルタの取付け構造を説明する平面図である。第5図(a)は実施例で使用されたチャップ型ノイズフィルタの外観を示す斜視図、第5図(b)はその等価回路図である。第6図(a)、第6図(b)は従来のチャップ型ノイズ

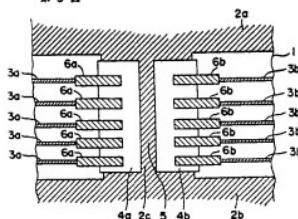
(c) はその等価回路図である。

1…基板、2a.2b.2c…グランド構体、3a.3b…信号導体路、4a.4b…絶縁層、5…グランド電極用接続部分(ギャップ)、6a.6b…導電性接続路、10…チャップ型ノイズフィルタ(チャップ型三端子コンデンサー)、(A)、(B)…信号電極、(C)…グランド電極。

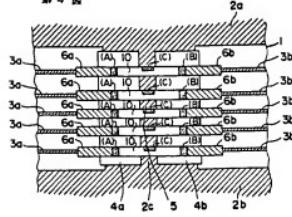
特許出願人 株式会社村田製作所  
代理人弁理士 森下武一



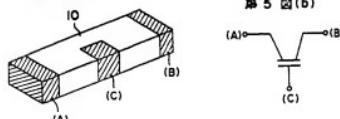
第3圖



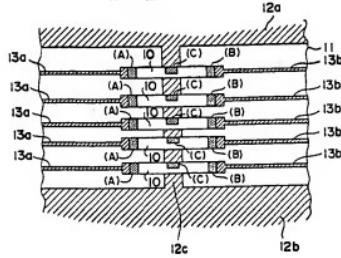
四



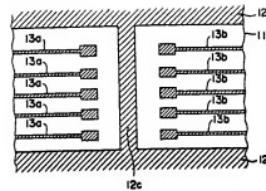
第5圖(a)



第6圖(a)



第6 図(b)



第6 図(c)

